

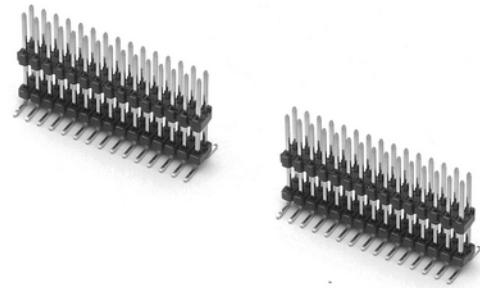
3533 3133

SMT Stiftheisen - RM 2,54mm - Sandwich-Type - Präzisionskontakte

SMT Pin Headers - Pitch 2,54mm - Double Body Type - Precision Contacts

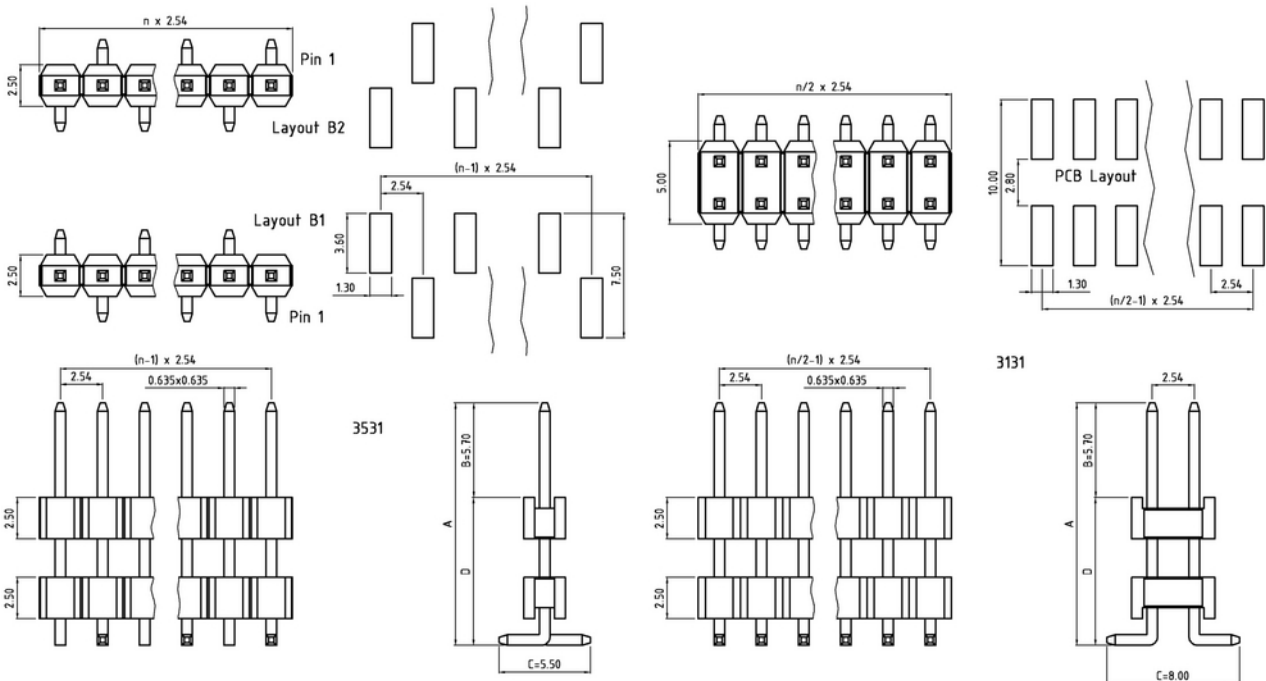
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0,635mm, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ω
Spannungsfestigkeit	1000V _{DC}
Test Voltage	1000V _{DC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-soldering, detailed information in ch. T



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serie:
Mates with Female Headers Series:
3490 / 3491 / 1531 / 1532



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Packing*
3133	16	020	00	0	00
Thermisch gerissene Kontakte Electro-strictioned contacts	16 A=15,80; D=8,50mm	003-050 Einreihig Single row	00 Vergoldet Gold plated	0 Für Serie 3133 For series 3133	00
3533 Einreihig Single row	17 A=17,90; D=10,60mm	004-100 Zweireihig Double row	10 0,25µm Gold 0,25µm gold plated	1 Layout B1 für Serie 3533 Layout B1 for series 3533	ST PPST
3133 Zweireihig Double row	18 A=19,70; D=12,40mm		50 Verzinkt Tin plated	2 Layout B2 für Serie 3533 Layout B2 for series 3533	PPTR
	19 A=20,90; D=13,60mm				
	20 A=23,00; D=15,70mm				

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options by request.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Lieferformen / Packing Options:

00 = Schüttgut ohne PP-Pad / Bulk good w/o PP-Pad
ST = In Stangen ohne PP-Pad / In tubes w/o PP-Pad
PPST = In Stangen mit PP-Pad / In tubes with PP-Pad
PPTR = Tape & Reel mit PP-Pad auf Anfrage / Tape & Reel packing with PP-Pad on request

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX.: +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Information

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{S_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{S_{max}}$) - Zeit ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{S_{max}}$ to T_p)	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{S_{min}}$) - Temperature Max ($T_{S_{max}}$) - Time ($t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

